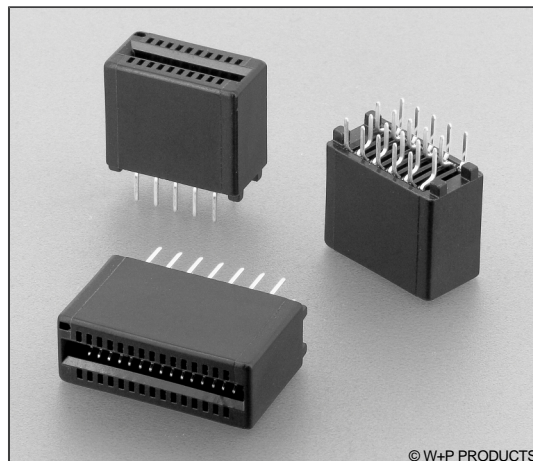


## Card Edge Verbinder RM 1,27mm, gerade – Single Slot Version Card Edge Connectors, 1.27mm Pitch, Straight – Single Slot Version

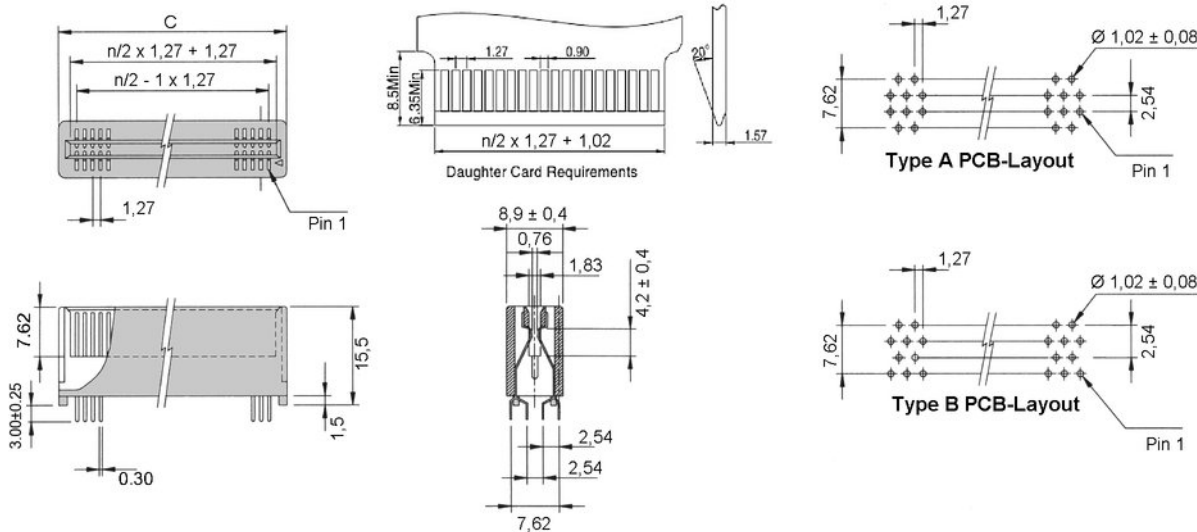
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Farbe <i>Colour</i>	Schwarz <i>Black</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Im Kontaktbereich vergoldet / Lötseite verzinkt (über Ni) (andere Veredelungen auf Anfrage) <i>Au plated contact area / Sn plated solder area (over Ni)</i> <i>(More plating options on request)</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 30 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	125 V AC max.
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55 °C ... +105 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>
Mechanische Haltbarkeit <i>Mechanical Durability</i>	Min. 100 Steckzyklen <i>Min. 100 mating cycles</i>



© W+P PRODUCTS

Empfohlene Steckkartendicke:  
1,60mm+/-0,30  
Recommended PCB thickness:  
1.60mm+/-0.30



<b>Series</b>	<b>Contacts*</b>	<b>Type*</b>	<b>Plating</b>
<b>121</b>	<b>080</b>	<b>10</b>	<b>60</b>
	010 C=10,80mm 012 C=12,07mm 020 C=17,15mm 030 C=23,50mm 040 C=29,85mm 050 C=36,20mm 060 C=42,55mm 080 C=55,25mm 100 C=67,95mm 120 C=80,65mm	10 Type A 20 Type B	60 Sel. Au/Sn Duplex plating

Auf Anfrage auch mit Befestigungsflansch lieferbar.  
Also available with mounting ears.

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

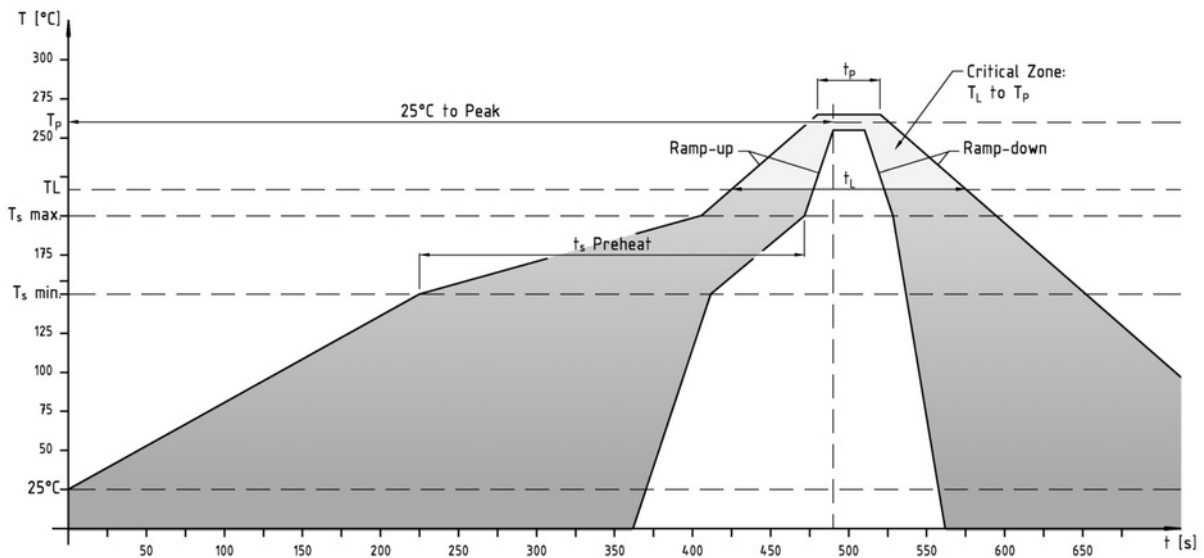
#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150 °C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217 °C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$	max. 8m

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150 °C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217 °C
Duration above $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature $T_P$	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	max. 8min



## Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

### Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.  
*Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.*

Empfohlenes Wellenlötprofil:  
*Recommended wave soldering profile:*

